

## 상용화 대상기술 조사표

구 분	내 용
연구자	성명 : 김유광 / 부서명 : 위성임무보증연구담당
기술명(국문)	패러린코팅 공정을 이용한 우주급 고집적화 인쇄회로기판 컨포멀 코팅공정 검증기술
기술명(영문)	Process Qualification for Parylene Conformal Coating of High-Integrity PCB for Space Usage
기술개요	진공증착방식을 활용한 우주급 고집적화 인쇄회로기판의 패러린 컨포멀 코팅공정 기술
기술특성	<ul style="list-style-type: none"> <li>-기존의 Acrylic 또는 Urethane 계열 재료가 아닌 Parylene 재료 이용</li> <li>-기존의 우주급 컨포멀코팅 적용기술(Brushing/Dipping)과는 다른 진공증착방식(CVD)을 활용</li> <li>-선택적 마이크로단위 두께 설정 가능 코팅공정</li> <li>-모든 표면에 균일도포 가능 코팅공정</li> <li>-우주급 활용가능 여부를 검증할 수 있는 시험 절차</li> </ul>
기술 도출시기	2020년 12 월
관련 연구과제	과제명 : 고-집적화 인쇄회로기판(PCB)의 우주급 고신뢰성 코팅공정기술(진공박막 컨포멀 코팅) 국산화 연구 / 계정번호 : KR20264
관련 지재권	특허 : S/W :
활용분야	우주급 부품을 활용하여 위성용 전자장비를 제작하는 산업체 및 COTS 부품을 우주용으로 활용하고자 하는 산업체는 극심한 우주환경에서 고신뢰성을 확보하기 위하여 균일하고 마이크로 단위로 도포 가능한 PCB 코팅공정 적용에 활용 가능함 또한, 극심한 우주환경에서의 검증시험을 통해 확인된 고신뢰성 코팅공정은 우주활용 이외에도 정밀하고 고내구성이 요구되는 균일 박막 코팅이 필요한 모든 산업분야에도 즉시 활용가능함
희망 사업화 형태	기술이전
사업화 추진 예상 시기	2021년 5월 예상 (기술이전 등 사업화 추진 예상 시기)
예상 기술료	추후 협의
사업화 가능기업	-
기타 사항	